

2005年3月2日

インテル^(R) Itanium^(R) 2 プロセッサに対応し、FSBを667MHzに高速化したチップセットと
インテル社仮想化技術に連動する日立仮想化機構を世界で初めて開発
Intel Developer Forum Spring 2005にて初公開

日立製作所 情報・通信グループ(グループ長&CEO:古川 一夫、以下 日立)は、インテル^(R) Itanium^(R) 2 プロセッサに対応し、FSB(フロント・サイド・バス)^{*1}を667MHzに高速化したチップセットを世界に先駆け開発しました。さらに、インテルコーポレーション(以下、インテル社 本社:米国カリフォルニア州サンタクララ)の仮想化技術に連動する日立仮想化機構(仮称)を開発し、次世代インテル^(R) Itanium^(R) 2 プロセッサ(コードネーム:Montecito)上で動作することを確認しました。これらの技術は、インテル社主催の「Intel Developer Forum Spring 2005」にて初公開します。さらに、製品化に向け、インテル社と共同で評価・検証を推進していきます。

^{*1}:メモリ サブシステムや拡張バス、入出力インターフェイスなど、プロセッサの外側にあるデバイスを接続するための伝送路

本技術はインテル社主催「Intel Developer Forum Spring 2005」(3月1日から3月3日、米カリフォルニア州サンフランシスコ)の基調講演で公開され、Technology Showcase内の日立ブースで「BladeSymphony」によるFSB667MHzのチップセットのデモ展示を、インテル・パビリオンでは日立仮想化機構のデモ展示を行います。

今回の発表にあたり、インテル コーポレーション 上級副社長 兼 デジタル・エンタープライズ事業本部長のパトリック・P・ゲルシンガーは次のように述べています。

「本日公開されたハードウェア・ベースの仮想化技術のデモンストレーションは、インテルと日立製作所の緊密な協力関係の成果です。日立製作所のチップセットとインテル^(R) Itanium^(R) プロセッサ・ファミリおよびインテルの仮想化技術を組み合わせた先進的なサーバ・プラットフォームにより、企業内においてより優れた仮想化ソリューションを求めるITマネージャに真の利点を提供するものとなります。」

今回開発した技術の特長は下記の通りです。

1. FSBを667MHzに高速化したチップセットを開発 [世界初]

FSBを667MHzに高速化したチップセットの開発においては、日立がメインフレームで培ってきた高速化論理設計技術やプリント基板の実装技術を適用しています。FSBの高速化により、SPEC CPU2000 Benchmarkで最大15%^{*2}、STREAM Benchmarkで最大40%^{*2}の性能向上を実現します。これにより、大規模メモリを使用する科学技術計算やデータベース業務においてインテル^(R) Itanium^(R) 2 プロセッサのパフォーマンスを活かした高い処理能力を提供します。

^{*2}:FSB400MHzとの当社比

2. インテル社仮想化技術に連動する日立仮想化機構を開発 [世界初]

サーバの仮想化を実現するインテル社の仮想化技術と連動する日立仮想化機構を開発しました。本技術は日立メインフレームで提供してきたプロセッサ仮想化向けの組み込みソフトウェア技術を採用したもので、インテル社と共同で動作検証を実施しました。プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースを複数の論理的な区画に分割し、ソフトウェアの改変なしに業務を動作させる環境を提供することで、より柔軟なシステム構築を実現します。

他社商標注記

- ・インテル、Intel、Itanium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- ・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

取扱事業部・照会先
株式会社 日立製作所 情報・通信グループ
エンタープライズサーバ事業部 事業企画本部 企画部 【担当:松村】
〒140 - 0013 東京都品川区南大井六丁目26番3号 大森ベルポートD館
電話:03 - 5471 - 2919(ダイヤルイン)

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
